

EC360 GLUE

Wärmeleitkleber Serie

Eine Mischung aus organischer Silikonpaste und Filler ermöglichen den Wärmeleitklebern der EC360® GLUE Serie eine Kombination aus hoher Wärmeleitfähigkeit und exzellenter Klebehaftung. Diese Kombination machen sie die perfekten Flüssigkleber für viele Anwendungen, wie das Befestigen von Kühlern auf RAM, Northbridge und anderen

elektrischen Komponenten. Die vergleichsweise starke Klebehaftung erlaubt auch die sichere Befestigung von schwereren Kühlern, bei der schwächere Kleber versagen. Der gehärtete Kleber hat eine silkonartige Struktur und ist dadurch flexibel und elektrisch isolierend.

Material Zusammensetzung

Typ	Prozentsatz
Wärmeleitfähige Materialien	40%
Silikone	35%
Filler	25%

Typen und Konfigurationen

Typ*	Verfügbare Größen*
Tube	10 g, 30 g

* Andere Konfigurationen und Größen sind auf Wunsch möglich, für gewerbliche Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: sales@extremecool360.de

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Einheit	Wert	Testmethode
Farbe	-	weiß	Visuell
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	2,0	ASTM D5470
Thermischer Widerstand	°C-in2/W	0,246	ASTM D5470
Evaporation	%	0,001	-
Zugfestigkeit	MPa	1,8	-
Trocknungszeit(25°C)	minutes	6,0	-
Dielektrizitätskonstante	1Mhz	5,0	ASTM D 150
Betriebstemperatur	°C	-60 - 250	EN 344

Installationsempfehlung

- Oberflächen von Fett und anderen Verunreinigungen befreien, wir empfehlen die Säuberung mit 90% Isopropylalkohol.
- Dann eine dünne Schicht Wärmeleitkleber auf das zu befestigende Objekt(z.B. einen Kühler) auftragen. Nun das zu befestigende Objekt vorsichtig auf der zu beklebende Fläche(z.B. ein RAM-Speicherchip) positionieren und leicht andrücken.
- Nun 30 Minuten warten damit der Kleber sich aktivieren und vollständig trocknen kann.